2026年12月期
第3四半期決算説明会

2026年11月11日（水）

メック株式会社

証券CODE:4971

https://www.mec-co.com/

2026年12月期 第3四半期 業績概況

1

売　　上：　19,730百万円（前年同期比　31.6%増加）
営業利益：　6,696百万円（前年同期比　57.6%増加）

2

為替の影響は前年同期比
売　　上：1,182百万円増加、営業利益：740百万円増加

3

薬品売上：　19,361百万円（前年同期比　33.0%増加）
出 荷 量 ：　41,596ton　（前年同期比　19.4%増加）

4

主要製品売上は前年同期比
EXE 34.4%増加、CZ 31.7%増加、V-Bond 16.6%増加、SF 14.9%減少

為替レート

（単位：円）

	期初想定	2026 3Q	2025 3Q	2026 1H
N T D	4.95	5.00	4.75	5.01
R M B	21.24	23.22	20.60	23.02
T H B	4.67	4.87	4.48	4.91
E U R	175.76	184.18	165.47	184.70
U S D	151.02	158.60	148.79	158.28

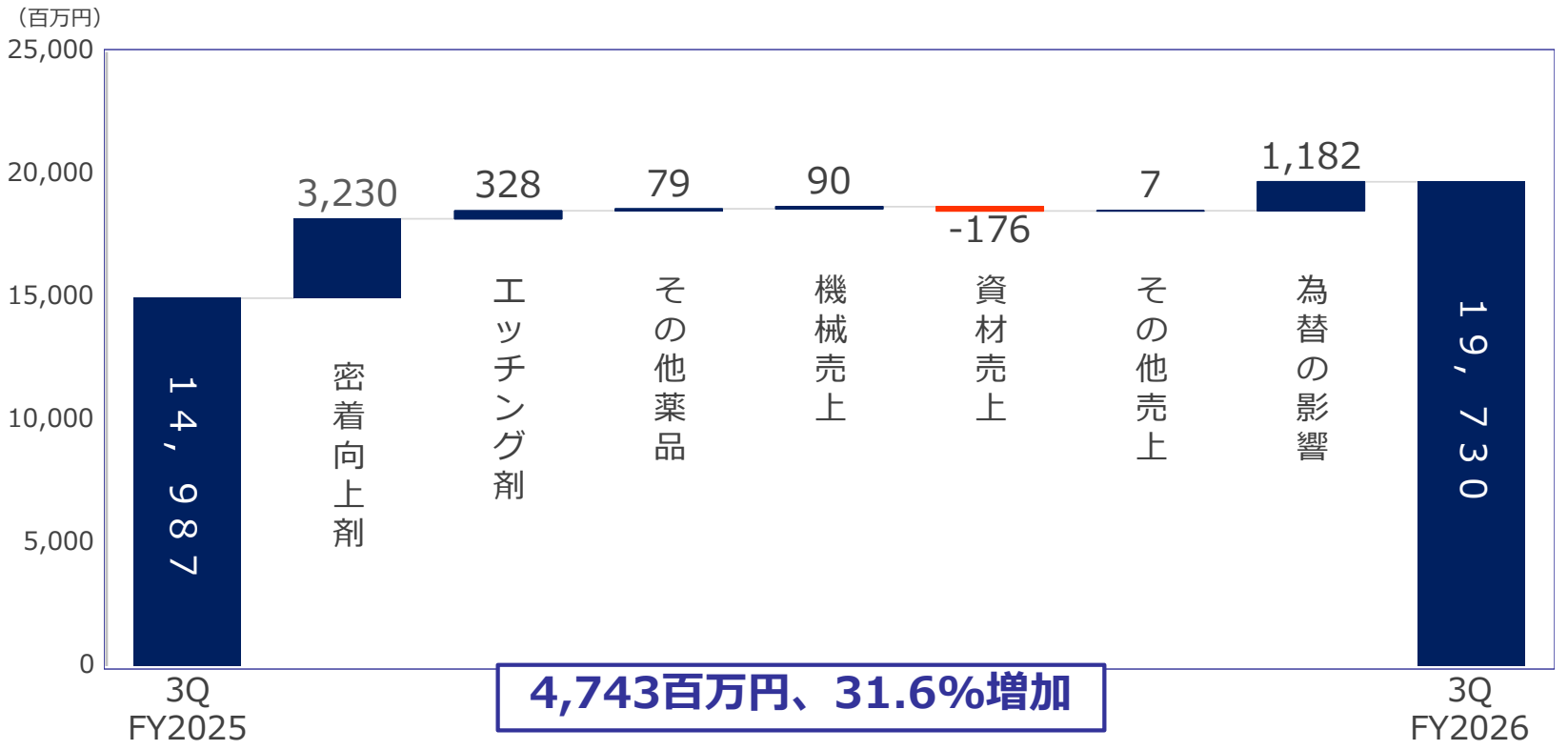
- 海外現地法人は、基本的に現地通貨建てでの取引きであり、連結会計で円換算する際に、円／現地通貨レートの影響を受ける
- いずれも、期中平均レートを採用
- 当社の主要外国通貨は、
  台湾ドル（NTD）および中国人民元（RMB）
- 各通貨に対して想定レートから0.1円変動する場合の影響額は次のとおり
  NTD：（売上高）72百万円 （営業利益）50百万円
  RMB：（売上高）28百万円 （営業利益）17百万円
  ＊いずれも、3Q実績

2026年12月期 第3四半期業績概要

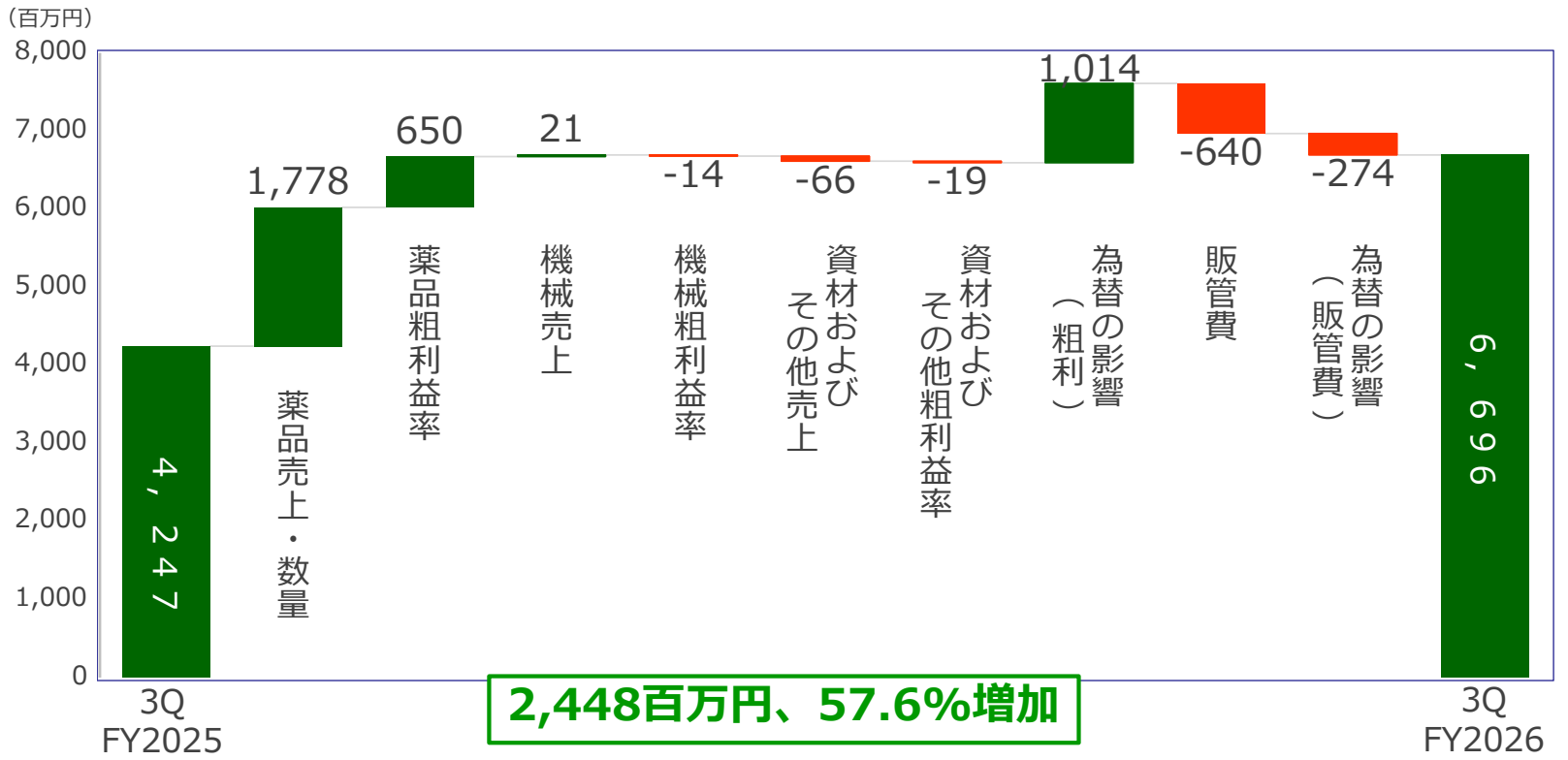
（単位：百万円）

	第3四半期						通期		
	FY25.12 3Q		FY26.12 3Q				FY25.12	FY26.12	
	（実績）	進捗率	（実績）	進捗率	前年同期比		（実績）	（予想）	前期比
売上高	14,987	71.5%	19,730	74.5%	4,743	31.6%	20,947	26,500	26.5%
薬品売上高	14,559	-	19,361	-	4,802	33.0%	20,211	-	-
売上総利益	9,349	-	12,712	-	3,363	36.0%	12,977	-	-
売上総利益率	62.4%	-	64.4%	-	-	-	62.0%	-	-
販売費及び一般管理費	5,101	-	6,016	-	914	17.9%	7,229	-	-
売上高比率	34.0%	-	30.5%	-	-	-	34.5%	-	-
営業利益	4,247	73.9%	6,696	77.9%	2,448	57.6%	5,748	8,600	49.6%
営業利益率	28.3%	-	33.9%	-	-	-	27.4%	32.5%	-
経常利益	4,361	72.1%	6,796	78.1%	2,435	55.8%	6,051	8,700	46.8%
経常利益率	29.1%	-	34.4%	-	-	-	28.9%	32.8%	-
税引前四半期(当期)純利益	4,761	-	6,789	-	2,028	42.6%	6,473	-	-
四半期(当期)純利益	3,329	66.2%	4,823	79.1%	1,494	44.9%	5,028	6,100	21.3%
EBITDA	5,364	-	7,444	-	2,080	38.8%	7,302	-	-
1株当たり四半期(当期)純利益	179.53	-	264.16	-	-	-	272.14	334.05	-
1株当たり配当金（円）	-	-	-	-	-	-	96.00	110.00	-
ROE	12.1%	-	14.5%	-	-	-	17.5%	17.9%	-

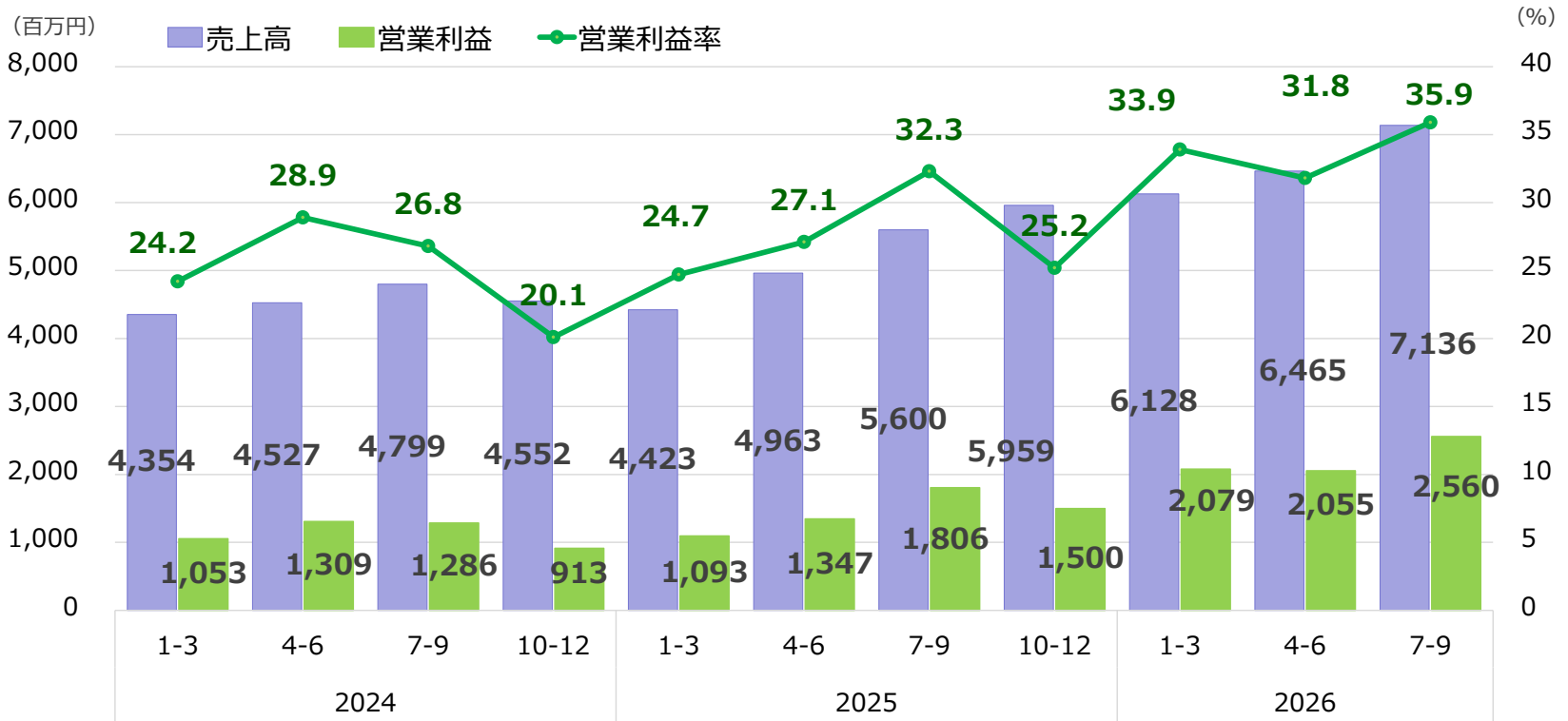
連結売上高前年同期比分析



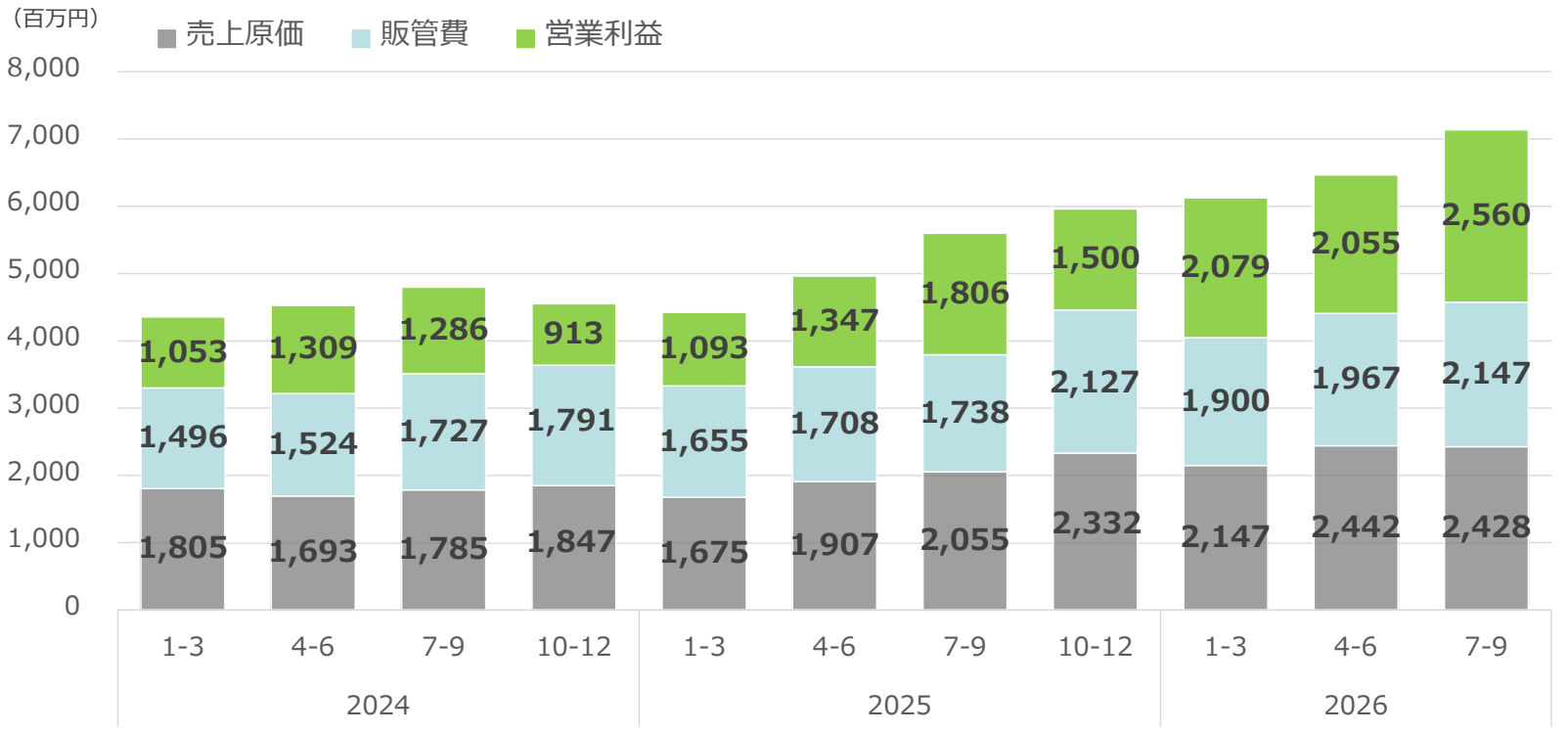
連結営業利益前年同期比分析



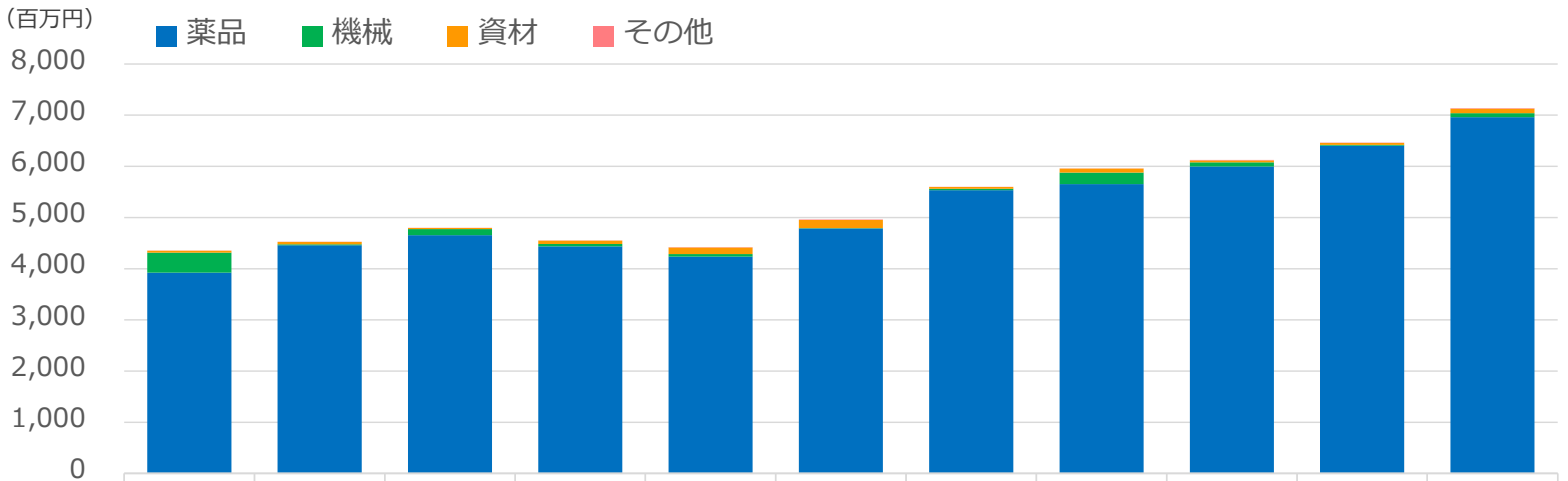
連結売上高と営業利益/営業利益率



連結損益構造

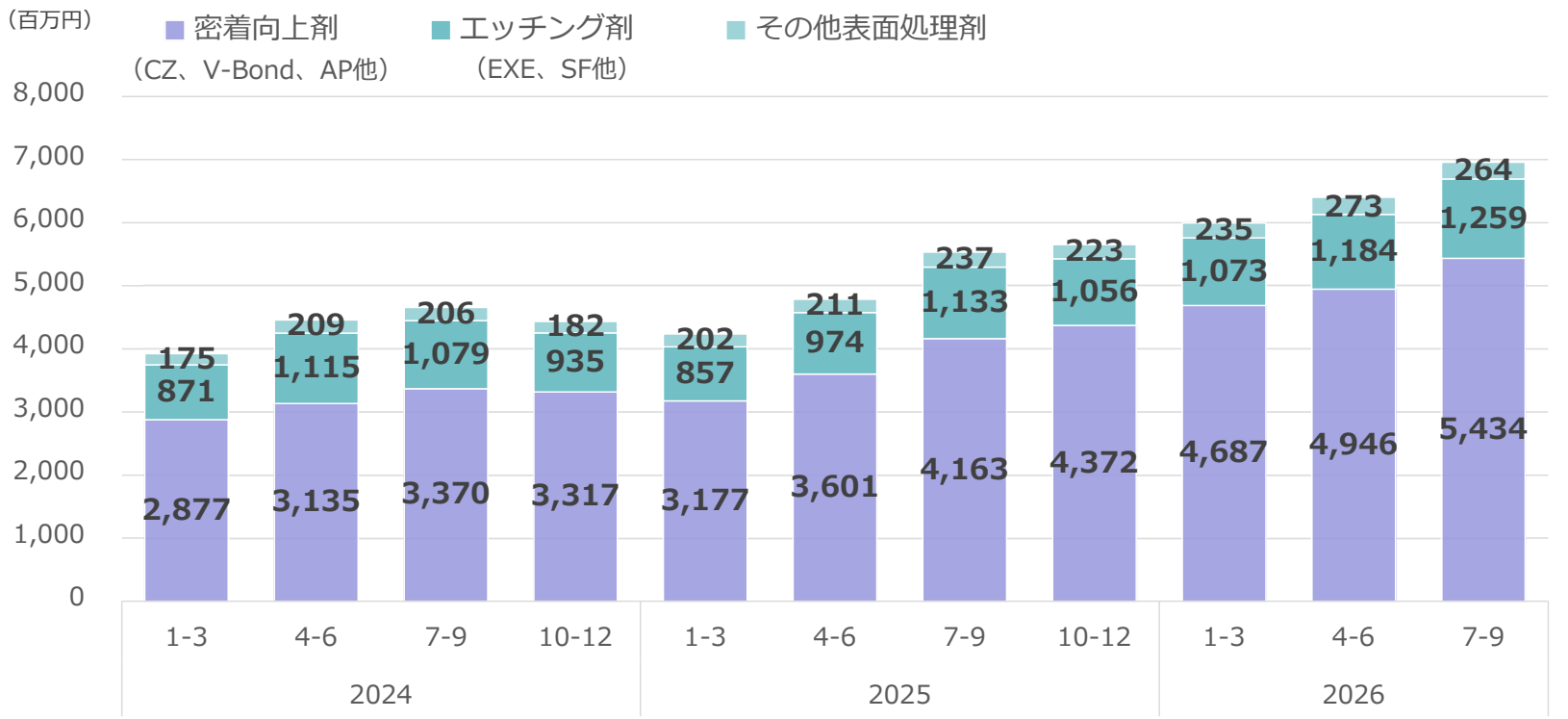

（百万円）
売上原価
販管費
営業利益
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1,053
1,496
1,805
1,309
1,524
1,693
1,286
1,727
1,785
913
1,791
1,847
1,093
1,655
1,675
1,347
1,708
1,907
1,806
1,738
2,055
1,500
2,127
2,332
2,079
1,900
2,147
2,055
1,967
2,442
2,560
2,147
2,428
1-3
4-6
7-9
10-12
1-3
4-6
7-9
10-12
1-3
4-6
7-9
2024
2025
2026

連結品種別売上高

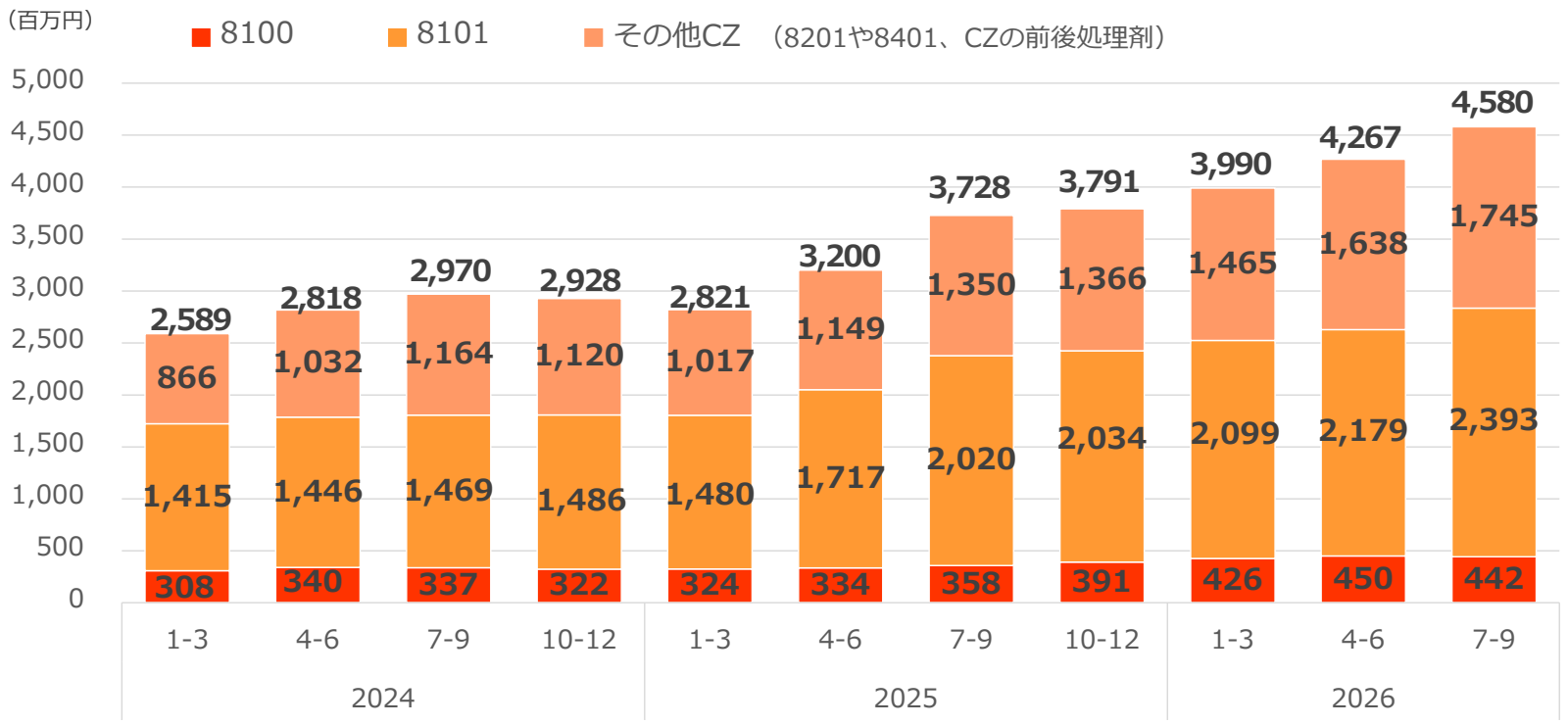


	2024 1-3	2024 4-6	2024 7-9	2024 10-12	2025 1-3	2025 4-6	2025 7-9	2025 10-12	2026 1-3	2026 4-6	2026 7-9
その他	1	3	1	1	8	7	2	1	10	6	8
資材	37	44	22	64	128	160	33	80	38	38	88
機械	391	19	118	49	49	7	30	225	81	16	79
薬品	3,924	4,460	4,657	4,436	4,237	4,787	5,534	5,652	5,997	6,404	6,959

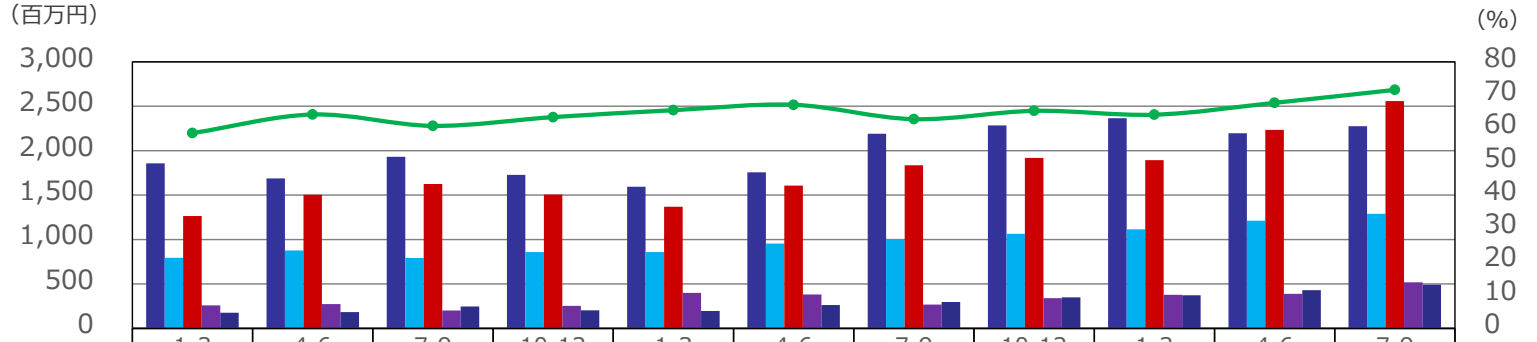
連結薬品別売上高


（百万円）
密着向上剤
（CZ、V-Bond、AP他）
エッチング剤
（EXE、SF他）
その他表面処理剤
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
175
871
2,877
209
1,115
3,135
206
1,079
3,370
182
935
3,317
202
857
3,177
211
974
3,601
237
1,133
4,163
223
1,056
4,372
235
1,073
4,687
273
1,184
4,946
264
1,259
5,434
1-3
4-6
7-9
10-12
1-3
4-6
7-9
10-12
1-3
4-6
7-9
2024
2025
2026

ＣＺシリーズ売上高


（百万円）
8100
8101
その他CZ （8201や8401、CZの前後処理剤）
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2,589
866
1,415
308
2,818
1,032
1,446
340
2,970
1,164
1,469
337
2,928
1,120
1,486
322
2,821
1,017
1,480
324
3,200
1,149
1,717
334
3,728
1,350
2,020
358
3,791
1,366
2,034
391
3,990
1,465
2,099
426
4,267
1,638
2,179
450
4,580
1,745
2,393
442
1-3
4-6
7-9
10-12
1-3
4-6
7-9
10-12
1-3
4-6
7-9
2024
2025
2026

地域セグメント別売上高



	2024 1-3	2024 4-6	2024 7-9	2024 10-12	2025 1-3	2025 4-6	2025 7-9	2025 10-12	2026 1-3	2026 4-6	2026 7-9
日本	1,857	1,688	1,931	1,728	1,594	1,756	2,191	2,284	2,366	2,197	2,275
台湾	795	878	792	859	860	954	1,006	1,065	1,115	1,212	1,290
中国	1,265	1,504	1,625	1,506	1,370	1,607	1,835	1,919	1,894	2,234	2,558
欧州	259	273	202	254	400	382	269	340	379	389	518
タイ	176	183	246	203	197	262	297	349	372	431	492
海外売上高比率	58.6	64.2	60.8	63.4	65.5	67.1	62.8	65.3	64.1	67.7	71.6

・日本国内代理店経由で販売した海外顧客への売上を海外売上高比率に含めた場合の比率は、82.6%（前年同一期間は、80.6%）。

今後の見通し

今後の見通し

事業環境

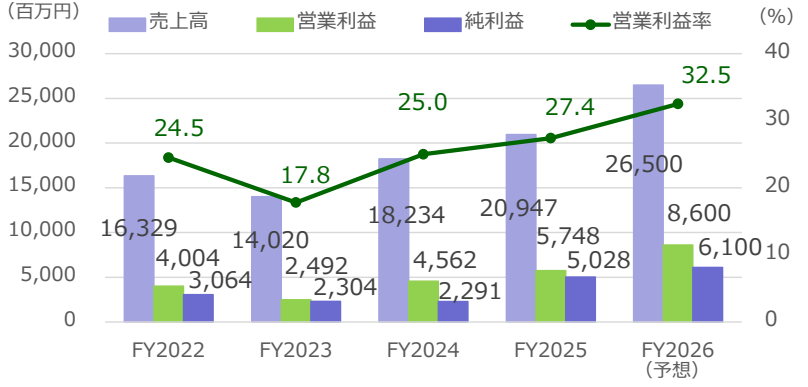
・中長期的には、IoTやAI、5G/6G、クルマの電動化・自動化・コネクテッド化やDX・GXの進展等、デジタル革命の進展に伴い技術革新が進む。
これら技術の広がりを背景に、当社関連市場の拡大を見込む。
・特に高まる半導体需要による半導体PKG基板の増加、超高密度化や超高周波化により、関連する「CZシリーズ」、「化学密着向上剤」需要の伸びを見込む。

主要製品

CZ　　：中長期的には半導体PKG基板の増加、大型・高多層化等により需要拡大を見込む。
V-Bond：衛星通信基板向け増加基調。クルマやスマートフォン市況の影響を受ける。
EXE　　：ディスプレイ需要の影響を受ける。
　　微細配線形成のニーズによりディスプレイ向け用途以外での需要増加を見込む。
SF　　：タブレットPC需要の影響を受ける。

2026年12月期 連結業績予想

	FY2025		FY2026					
			前回（8/10）公表値			今回（11/11）公表値		
	百万円	利益率(%)	百万円	利益率（%）	増減率	百万円	利益率（%）	増減率
売上高	20,947	-	25,800	-	23.2	26,500	-	26.5
営業利益	5,748	27.4	8,300	32.2	44.4	8,600	32.5	49.6
経常利益	6,051	28.9	8,500	32.9	40.5	8,700	32.8	43.8
純利益	5,028	24.0	6,000	23.3	19.3	6,100	23.0	21.3
1株当たり純利益(円)	272.14	-	328.58	-		334.05	-	-

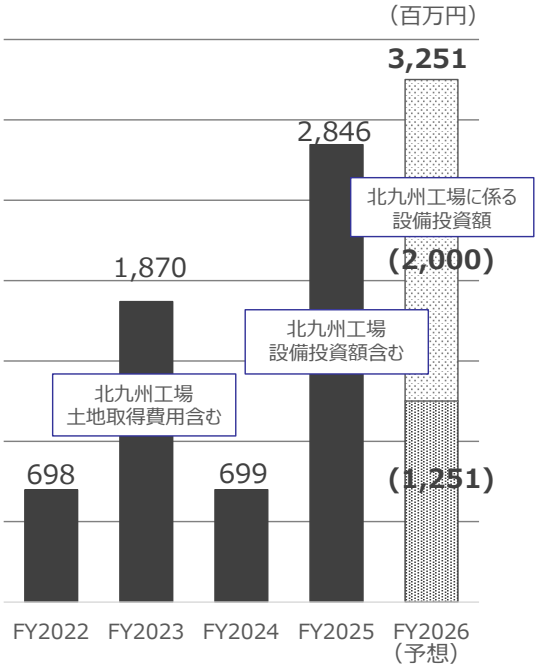


為替レート ※前回公表値の想定レートからの変更:無

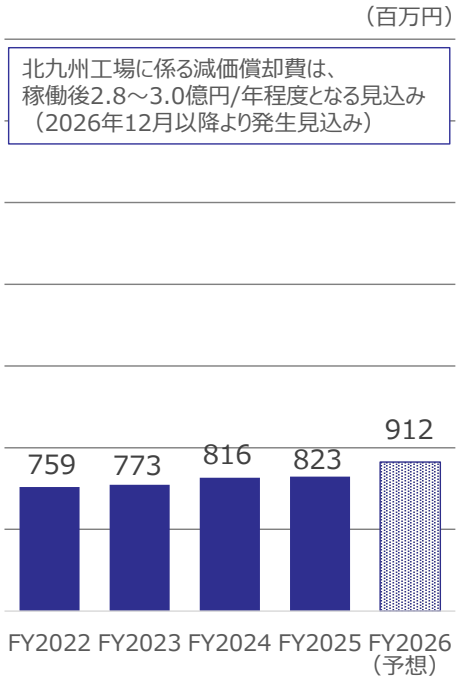
	FY2025（実績）	FY2026（想定）
NTD	4.81	4.96
RMB	20.94	22.58
THB	4.57	4.93
EUR	169.14	183.65
USD	150.40	156.45

設備投資額と減価償却費、研究開発費

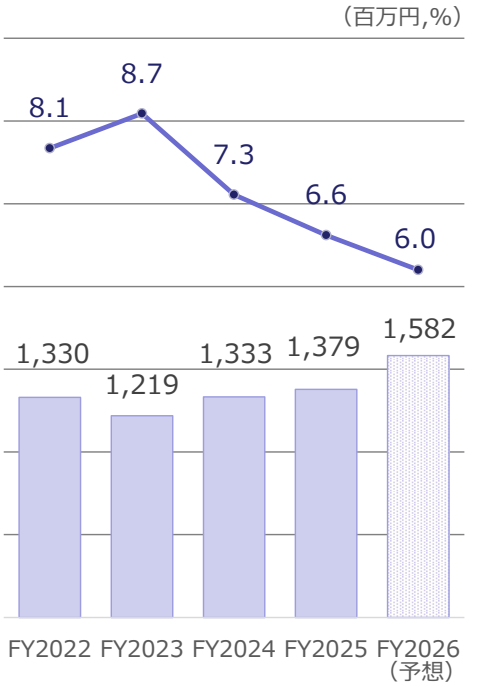
設備投資額



減価償却費



研究開発費と売上高研究開発費比率



固定資産取得

今後の需要拡大を見据え、供給体制を強化。
北九州工場の設備増強と長岡工場隣接地の取得を決定。（2026年9月30日開示）

北九州工場　第二期工事
福岡県北九州市若松区向洋町

投資額：約20億円
稼働開始：2028年度（予定）

- 半導体パッケージ基板向け薬品の生産設備を増強
- 第一期工事は2026年12月稼働開始予定
  本件はその第二期工事
- 半導体パッケージ基板関連製品の需要拡大への対応、拠点分散によるBCP強化、関連法令への対応
- 資金計画は自己資金および借入金（予定）

長岡工場　隣接地の取得
新潟県長岡市西陵町

投資額：約23億円
（土地、建物を含む）

- 長岡工場（量産工場）に隣接する土地・建物を取得
- 長岡工場は2033年に稼働開始から40年
  設備の大幅更新期を迎える見込み
- 現工場のリニューアル検討の選択肢が広がる
- 物件引き渡し期日は2027年3月31日
- 資金計画は自己資金（予定）

北九州工場について

今後の需要拡大を見据え、供給体制・BCP対応強化。

北九州工場　第一期工事
福岡県北九州市若松区向洋町

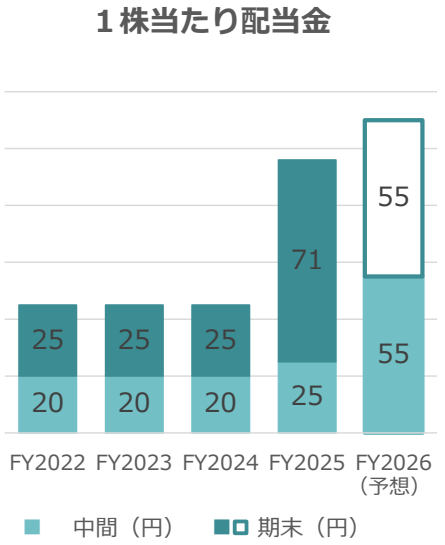
稼働開始：2026年12月稼働開始（予定）

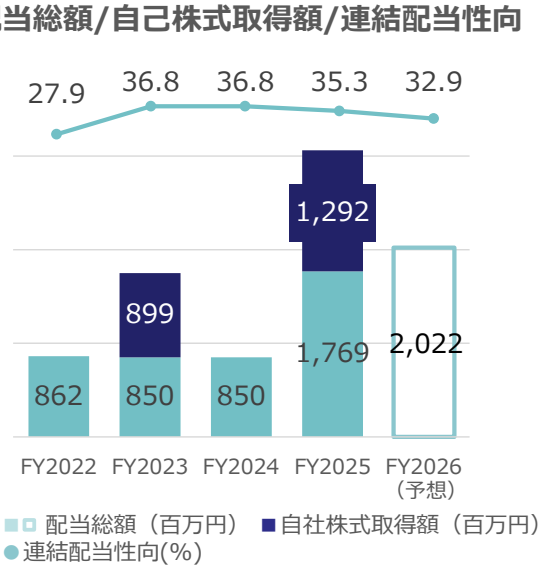
・主に、パッケージ基板製造用薬品を製造
・減価償却費 約３億円/年
・設備スペック上の生産能力 3万 t/年（2,500 t/月）
・従業員数は、稼働初期 約10名

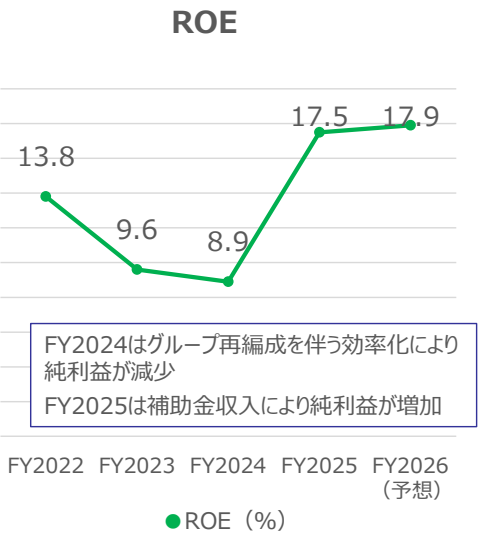


2026年10月下旬撮影

配当金と連結配当性向、ROEの推移







【株主還元方針】 ・連結配当性向35%以上かつDOE 4.0%以上
・自己株式取得は状況に応じ機動的に実施

【ROE目標】 13～16%

キャッシュ・アロケーション 基本方針

Phase 2（2025～2027年累計）キャッシュ・アロケーションの基本方針。
経営資本を投入し事業活動により得た利益は、バランスを見ながら株主還元や成長投資、基盤強化に配分します。

キャッシュイン・手元資金
（3年間累計の計画）

営業キャッシュフロー
18,200～18,800百万円
（研究開発控除前）

外部調達等

手元資金

キャッシュアウト
（3年間累計の計画）

投資 **8,000百万円＋α**	**投資の配分** ● 設備成長投資 ● 設備維持更新投資 ● 技術サポート・マーケティング体制の強化 ● M&A	**4,000百万円** **4,000百万円** **金額は適宜判断**
研究開発 **5,200百万円**	● 研究開発	**5,200百万円**
株主還元 **5,300～5,400百万円＋α**	● 配当金 ● 自己株式取得	**5,300～5,400百万円** **機動的に実施** （2025年 1,292百万円自己株式取得済）

※各項目の大きさはその額の大きさを示すものではありません。

ESGへの取り組み

Environment

- 環境負荷低減製品の開発
- 適正な化学物質管理
- 資源循環の推進
- 気候関連問題への対応

Social

- 人的資本戦略
- 多様な人財の活用（女性活躍、WLB、男性の育休取得推進等）
- 産業発展への貢献（高速通信整備、自動運転、AI、DX、GX等）

Governance

- 経営基盤の強化（CG体制、リスクマネジメント、コンプライアンスの徹底等）

PKG基板の超高密度化、超高周波化

超高密度
超高周波

最先端品 化学密着向上剤APシリーズ

先端品 CZ-8401
×化学密着向上剤APシリーズ
CZ-8201

汎用品 CZ-8101
CZ-8100



Flat Organic
Adhesion Promotor



Super finely roughen +
Organic Adhesion Promotor



Very finely roughened

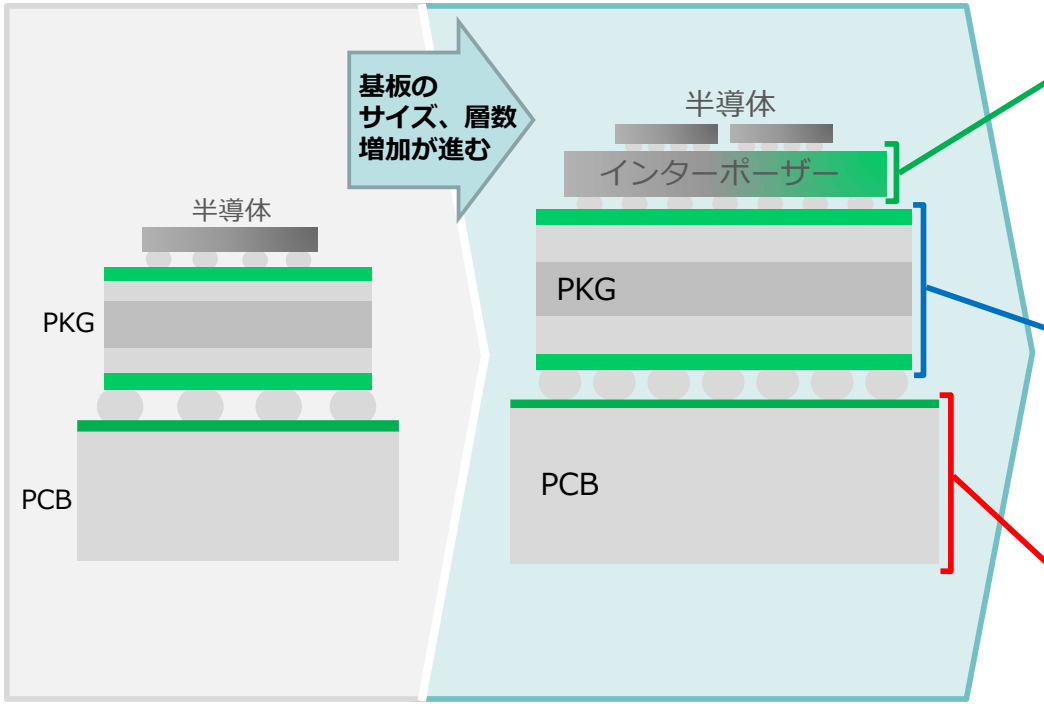


Finely roughened

技術領域の拡大を目指して

当社技術の進化と求められる技術

超高密度化、信号低損失、低消費電力



新領域（インターポーザー）

・適用製品：粗化密着処理（CZ）×化学密着処理（AP）
・技術動向：超高密度化（低L/S）
・想定する最終製品例：生成AI関連、データセンター

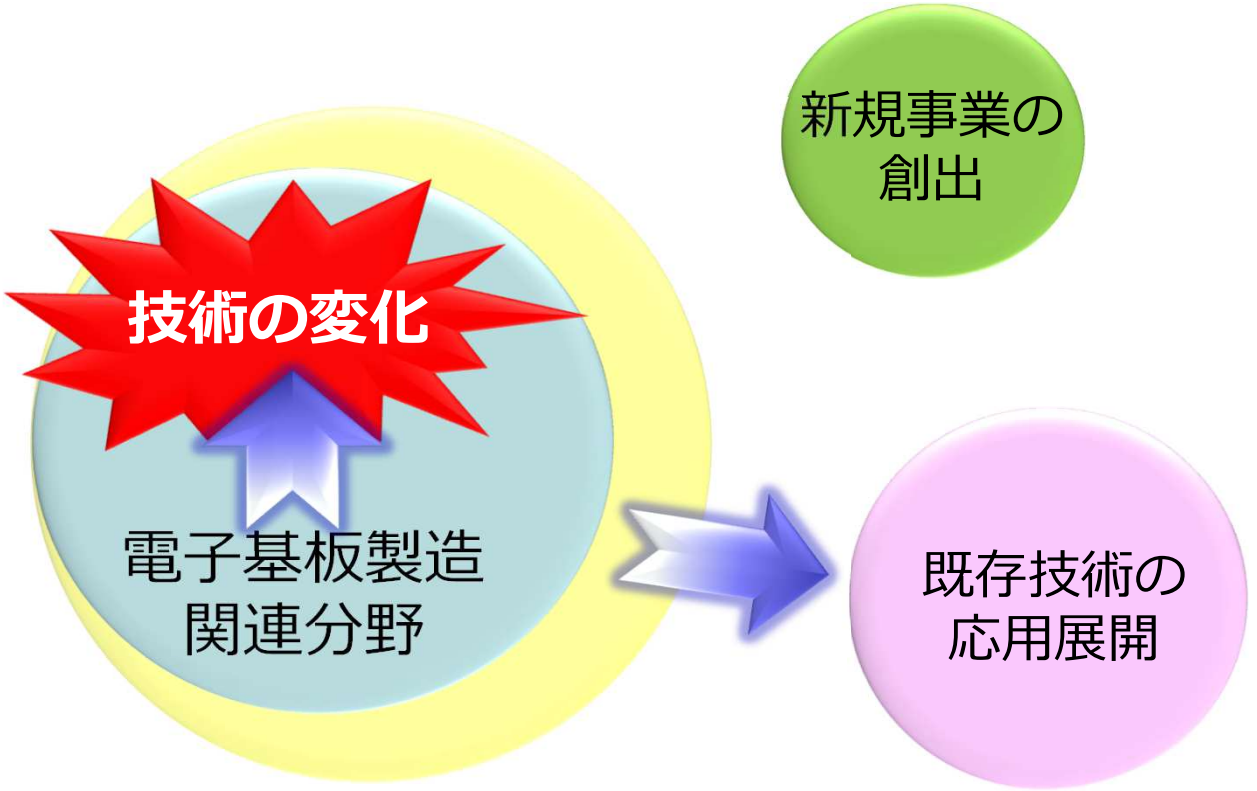
既存領域（PKG基板）

・適用製品：粗化密着処理（CZ）、化学密着処理（AP）
・技術動向：高密度化（低L/S）
　　低消費電力のニーズによる粗化量低減
・想定する最終製品例：生成AI関連、データセンター

新領域（高周波基板）

・適用製品：化学密着処理（AP）
・技術動向：信号低損失のニーズによる粗化量低減
・想定する最終製品例：生成AI関連、データセンター
　　半導体検査機

事業領域の拡大を目指して



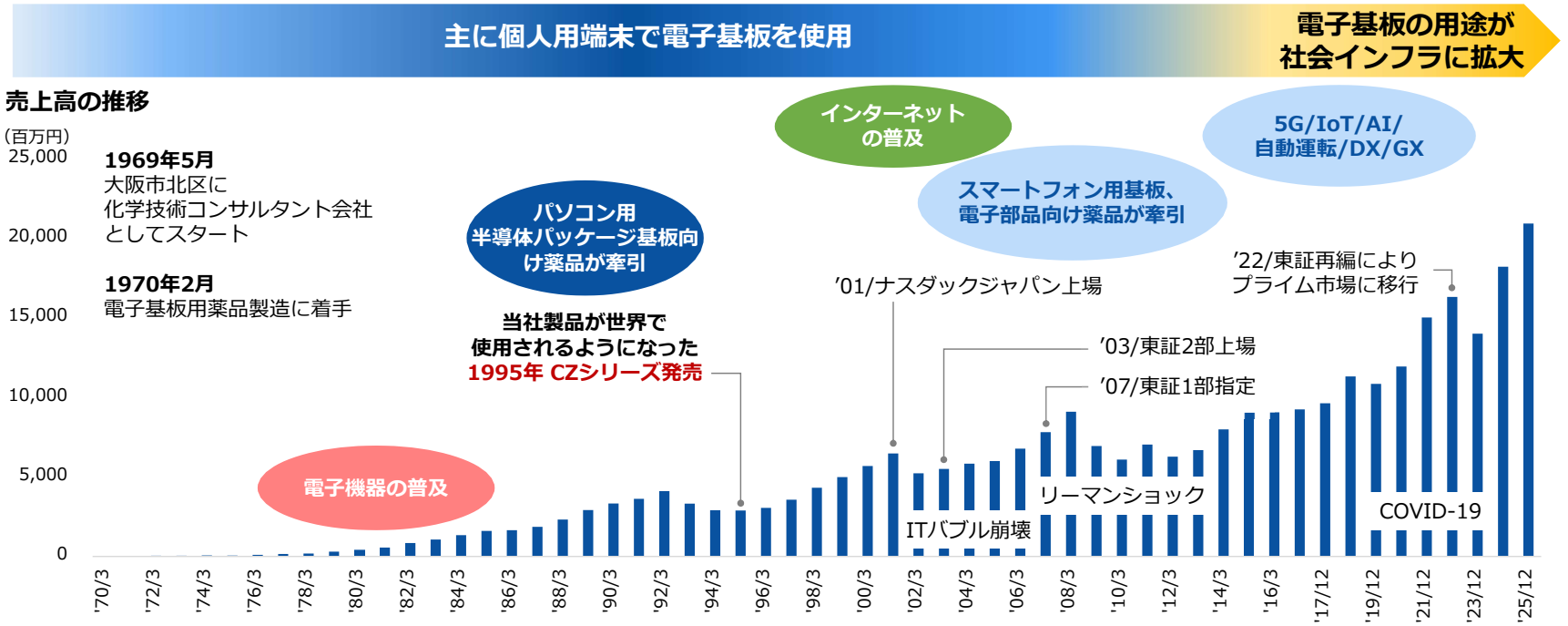
参考資料

会社概要

（2025年12月31日現在）

社名	メック株式会社　MEC COMPANY LTD.
本社所在地	兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号
設立年月日	1969（昭和44）年5月1日
主な業務内容	電子基板・部品製造用薬品の開発・製造販売 及び　機械装置、各種資材の販売
代表者	代表取締役社長　前田　和夫
資本金	5億9,414万2,400円
連結売上高	209億47百万円
上場市場	東証プライム市場（4971／化学セクター）
従業員数	連結508名、単体292名

創業からの軌跡



※2017年12月期（第49期）は、決算期変更により2017/4/1～12/31までの9カ月。なお、連結対象期間については、当社は9カ月間（2017/4/1～12/31）、連結子会社は12カ月間（2017/1/1～12/31）。

製品化の流れ　［薬液製品の開発］



研究所から
工場へ





テーマ決定 ⇒ ビーカー実験 ⇒ スケールアップ実験 ⇒ 応用ライン検証







お客様へ



製造 ⇒ 品質検査 ⇒ 充填

当社製品の使用工程例

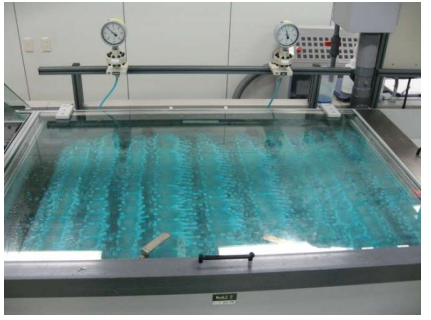
«乾燥処理»



«水洗処理»



«薬液処理»



基板受取



基板投入

界面価値創造

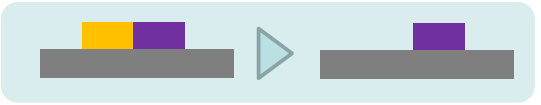
- 表面を**粗化**し、
  機械的に**密着性を向上**
  CZ、V-Bond



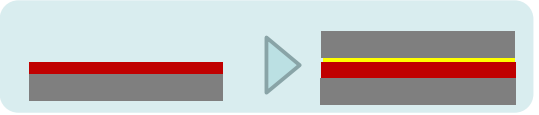
- **配線を形成**する
  EXE



- **選択エッチング**
  SF



- 表面を**処理**し、
  化学的に**密着性を向上**
  AP

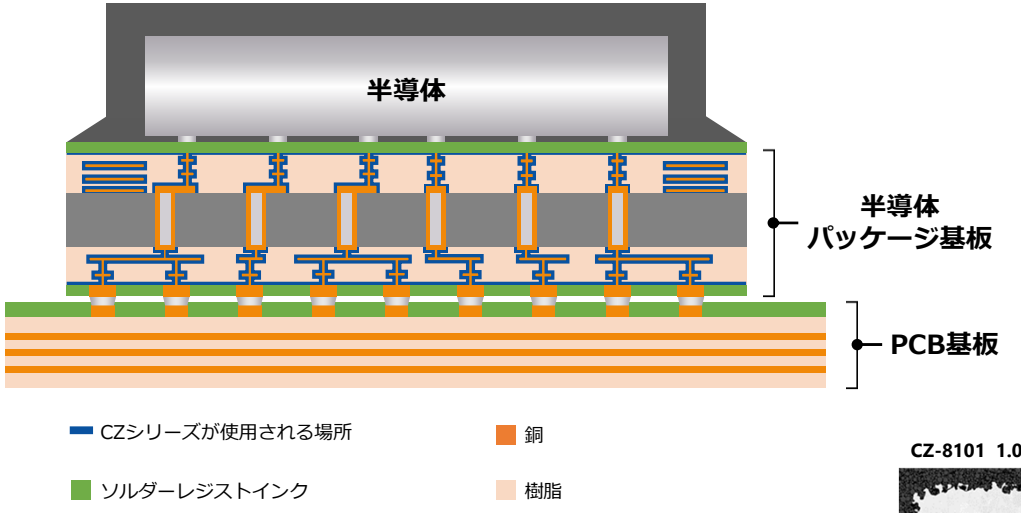


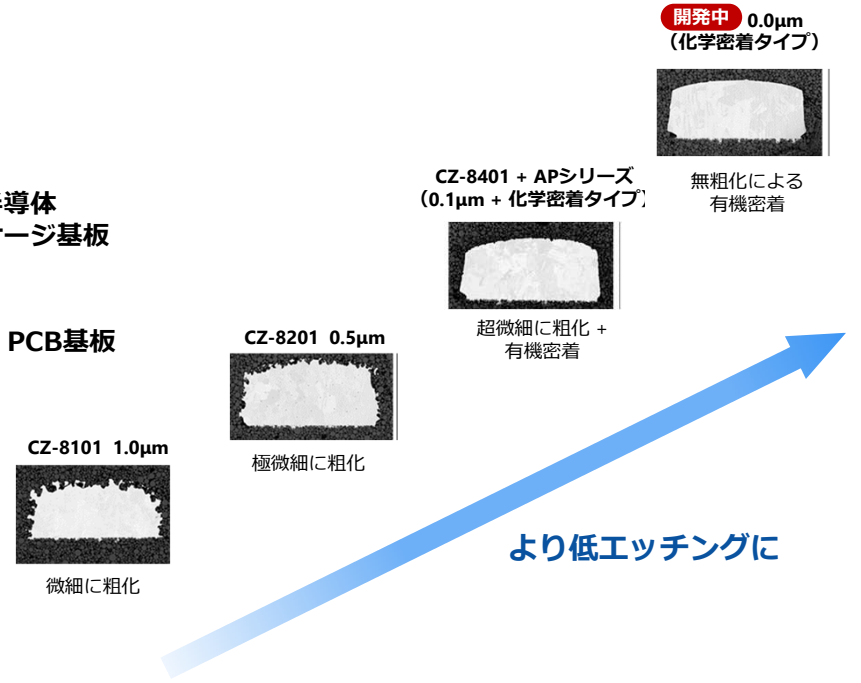
主要薬品用途と最終製品例

主要薬品	特徴	最終製品例
超粗化系密着向上剤 「CZシリーズ」	銅と樹脂との密着性を高める 銅表面処理剤。 主にPKG基板向けの密着向上剤で、 高密度PCBにも使用される。	生成AI関連、5G/6G関連・ データセンター等のインフラ、 パソコン・スマートフォン・ タブレットPC等の高機能デバ イス等
多層電子基板向け密着向上剤 「V-Bondシリーズ」	銅と樹脂との密着性を高める 銅表面処理剤。 多層基板向けの密着向上剤で、 PKG基板には使用されない。	クルマ、スマートフォン、 衛星通信等
異方性エッチング 「EXEシリーズ」	サブトラで微細配線形成ができる。 主にCOF基板向けのエッチング剤と して使用される。	テレビ・パソコンの モニター等
選択エッチング銅除去剤 「SFシリーズ」	銅への選択性を持ったエッチング剤。	タブレットPC等

当社の強み　層間密着技術

主力製品「CZシリーズ」は、銅と樹脂との密着が求められる界面で貢献しています。
半導体パッケージ基板の銅とビルドアップ樹脂との密着向上プロセスで欠かせない技術です。



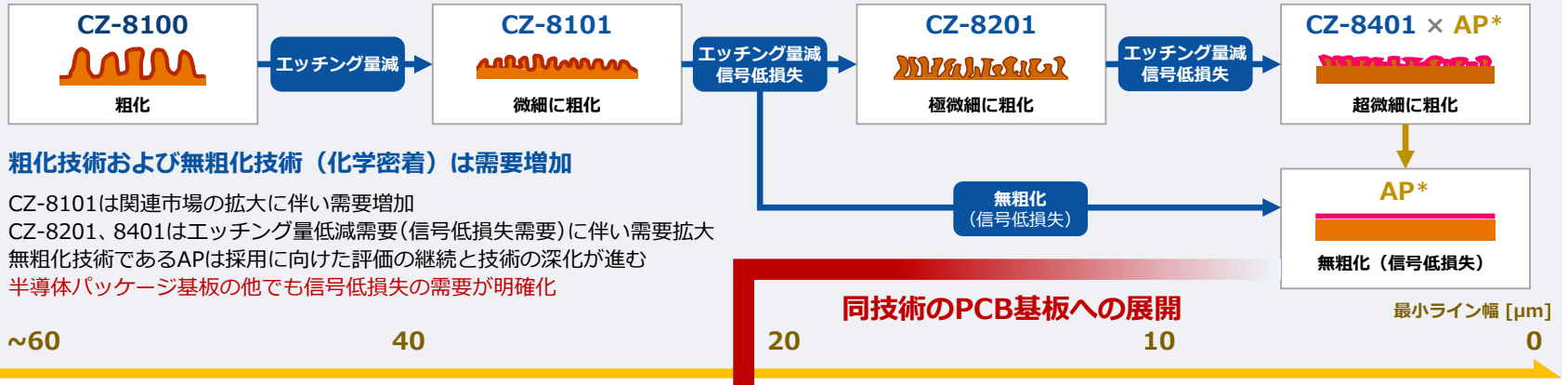


半導体パッケージ基板が大型化・高多層化

⇒ CZシリーズの使用量増加

銅表面密着技術の変遷

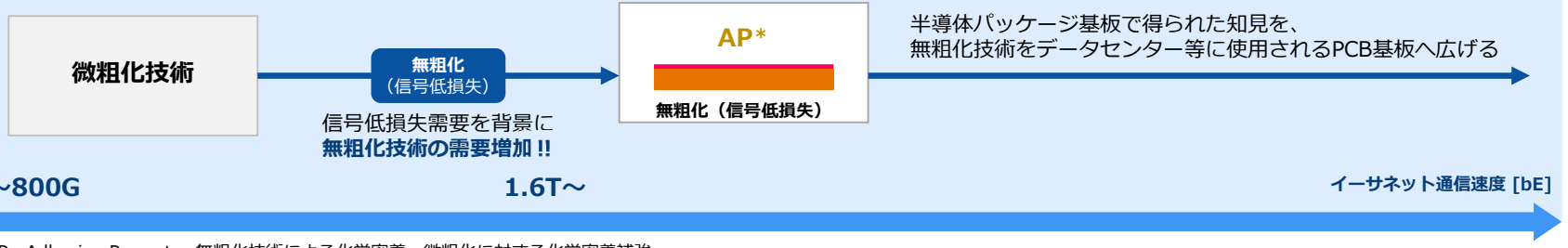
コア事業：半導体パッケージ基板



粗化技術および無粗化技術（化学密着）は需要増加

CZ-8101は関連市場の拡大に伴い需要増加
CZ-8201、8401はエッチング量低減需要（信号低損失需要）に伴い需要拡大
無粗化技術であるAPは採用に向けた評価の継続と技術の深化が進む
半導体パッケージ基板の他でも信号低損失の需要が明確化

応用展開：PCB基板（高周波基板）

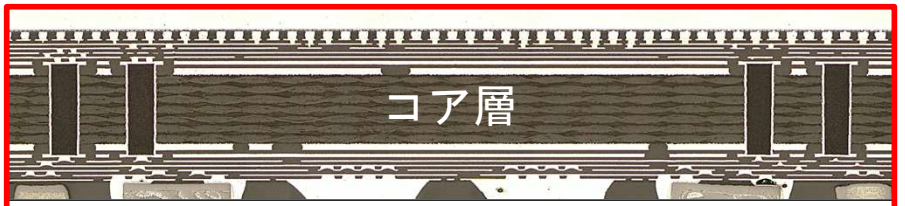


信号低損失需要を背景に
無粗化技術の需要増加 !!

半導体パッケージ基板で得られた知見を、
無粗化技術をデータセンター等に使用されるPCB基板へ広げる

＊AP：Adhesion Promotor 無粗化技術による化学密着、微粗化に対する化学密着補強

半導体パッケージ（PKG）基板の断面



Xeon　14層(6-2-6)



Core i7　8層(3-2-3)



Ryzen　12層(5-2-5)

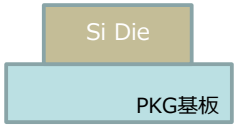
	PKG面積	層数
Xeon	27.44 cm^2	14
Core i7	14.44 cm^2	8
Ryzen	16.00 cm^2	12

*当社で入手、分解しました

半導体パッケージ（PKG）基板の進化

通常のPKG基板

一つのPKGに一つの半導体



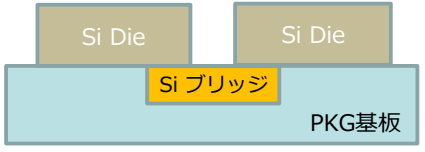
先端PKG基板（Chiplet、2.xDパッケージ）

PKGを大きくし**複数**の半導体を搭載

PKGの高密度化/サイズ大型化/高多層化

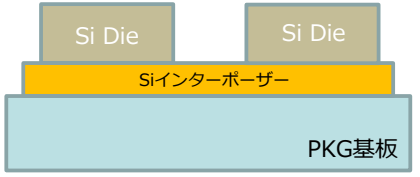
EMIB/EMIB-T

(**E**mbedded **M**ulti-die **I**nterconnect **B**ridge)



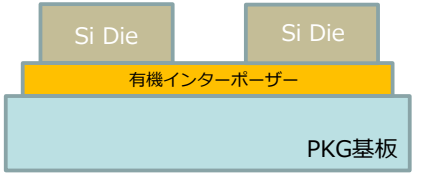
CoWoS-S

(**C**hip **o**n **W**afer **o**n **S**ubstrate)



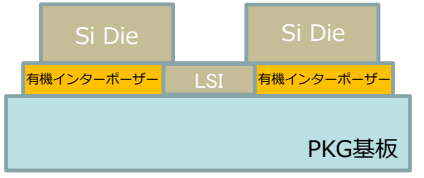
CoWoS-R

(**C**hip **o**n **W**afer **o**n **S**ubstrate)



CoWoS-L

(**C**hip **o**n **W**afer **o**n **S**ubstrate)



メックグループ設備能力

国内拠点



尼崎工場（少量多品種）
900 t /月



長岡工場（量産工場）
2,750 t /月

新拠点



北九州工場 イメージ
最大生産能力 2,500 t /月（予定）
2026年12月稼働（予定）

海外拠点



メック台湾
1,200 t /月



メック蘇州
1,350 t /月



メック珠海
1,000 t /月



メックヨーロッパ
400 t /月



メックタイ
500 t /月

2025年12月現在

※設備能力は設備スペック上の最大値です

界面価値創造

Creating and Fostering Value at Various Interfaces

このプレゼンテーション資料には、2026年11月11日現在の将来に関する予測が含まれております。記述している将来予測および業績予測は、当社が現時点で入手できる情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知ください。

MMEC